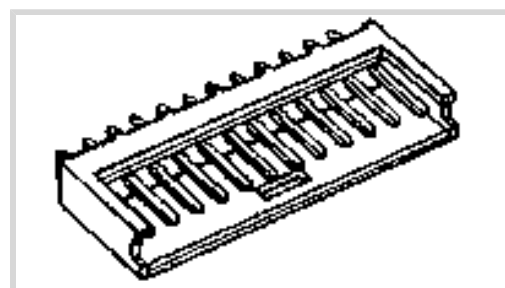




Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Leiterplattenstiftleisten und -buchsen



PCB-Steckverbindermontagetyp: **Stiftleiste für die Leiterplattenmontage**

Montageausrichtung für Leiterplatte: **Vertikal**

Steckverbindersystem: **Leiterplatte-an-Leiterplatte**

Anzahl von Positionen: **9**

Zeilenanzahl: **1**

## Eigenschaften

### Produktmerkmale

PCB-Steckverbindermontagetyp	Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
Steckverbindersystem	Leiterplatte-an-Leiterplatte
Stecksockeltyp	Teilweise ummantelt
Abdichtbar	Nein
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte

### Konfigurationsmerkmale

Ladungszustand des Steckverbinderkontakts	Voll bestückt
Montageausrichtung für Leiterplatte	Vertikal
Anzahl von Positionen	9
Zeilenanzahl	1

### Elektrische Kennwerte

Spannungsfestigkeit (max.)	750 V
----------------------------	-------

### Sonstige Eigenschaften

Profil des Steckverbinders	Standard
Primäre Produktfarbe	Schwarz

### Kontaktmerkmale

Dicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	2.5 µm
Kontaktform	Rund

Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers	Hell
Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Zinn
Kontaktmaterial	Messing
Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Gold
Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts	.381 $\mu\text{m}$ [15 $\mu\text{in}$ ]
Kontakttyp	Stift

### Klemmenmerkmale

Anschlussstift- und Restlänge	3.5 mm[.138 in]
Verbindungsmethode für Leiterplatte	Durchsteckmontage - Löten

### Montage und Anschlusstechnik

Gegensteckarretierung	Mit
Panelmontagevorrichtung	Ohne
Gegensteckführung	Mit
Typ der Gegensteckführung	Polarisierung
Arretierung für Leiterplattenmontage	Ohne
Montageausrichtung der Leiterplatte	Ohne
Art der Steckverbindermontage	Leiterplattenmontage

### Gehäusemerkmale

Raster	2.54 mm[.1 in]
Gehäusematerial	Thermoplast, Thermoplast

### Abmessungen

Reihenabstand	2.54 mm[.1 in]
---------------	----------------

### Verwendungsbedingungen

Gehäusenenntemperatur	Standard
Betriebstemperaturbereich	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

### Betrieb/Anwendung

Stromkreis Anwendung	Strom und Signale
----------------------	-------------------

### Industriestandards

UL-Brandschutzklasse	Nein
----------------------	------

### Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	500
------------------	-----

Verpackungs-Typ

Kasten

## Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf [TE.com](https://www.te.com) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2023 (233) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br oder Cl > 900 ppm.
Lötfähigkeit	Wellenlötfähig bis 265 °C

### Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## Kompatible Teile



Auch serienmäßig | **AMPMODU Headers**



Anschlusswannen für Leiterplatten-Steckverbinder(1)



Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinderkontakte(66)



Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindersätze und -gehäuse(5)



Laschen, Verriegelungen und Arretierungen für Leiterplatten(2)

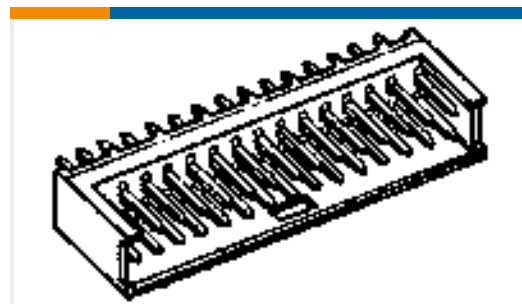
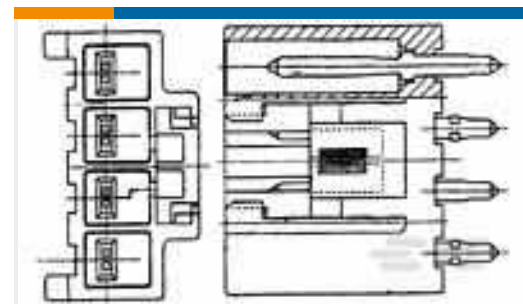
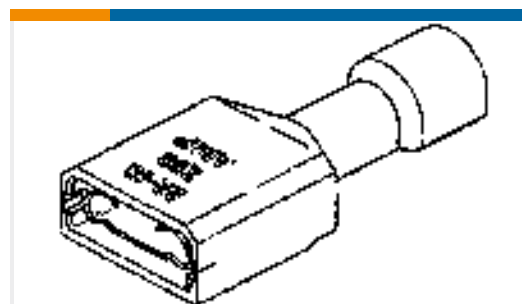


Leiterplattenstiftleisten und -buchsen (6117)



Montage von Leiterplatten-Steckverbindern(1)

## Kunden kauften auch diese Produkte

TE Teilnr.:280384-1  
2X4P AMPMODU II SHRD HDR, ST, TINTE Teilnr.:178487-1  
UP 3.96 4P TAB HDR NAT TYPE 1TE Teilnr.:2176398-2  
3502 15K 1%TE Teilnr.:5-2176331-3  
CRGP 2512 220K 1%TE Teilnr.:5-1879234-2  
SMD Leistungswiderstand: 7 Watt, 200 - 2M OhmTE Teilnr.:280373-1  
8P AMPMODU II SHRD HDR, ST, TINTE Teilnr.:1586872-1  
04P UMNL HDR ASSY, GWTE Teilnr.:1586869-1  
03P UMNL HDR ASSY, GWTE Teilnr.:5-520183-2  
ULTRA-FAST 250 ASY REC 22-18 AWG TPBR

## Dokumente



### Produktzeichnungen

[9P AMPMODU II SHRD HDR, ST, 0.38AU](#)

Englisch

---

### CAD-Dateien

[3D PDF](#)

3D

Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_280508-2\\_U\\_c-280508-2-u.2d\\_dxf.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_280508-2\\_U\\_c-280508-2-u.3d\\_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_280508-2\\_U\\_c-280508-2-u.3d\\_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

---

### Freigabe Agentur

[UL](#)

Englisch